

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2025-028

## 鸿日达科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股5,167万股，每股发行价格为人民币14.60元，本次发行募集资金总额为人民币75,438.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为67,582.85万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验字[2022]215Z0050号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

### 二、募集资金使用情况说明

公司分别于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意在不改变募投项目的投资方向、投资总额、实施内容的情况下，将原IPO募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“软硬件设备购置及安装费用、铺底流动资金合计23,687.01万元的募集资金”的内容变更由全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）利用其现有厂房实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的公告》（公告编号：2023-054）。

公司分别于2024年4月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、

使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中剩余“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金”的内容全部变更为由“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。两个新项目合计总投资为 27,194 万元，拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金，同时使用超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元增加投资额。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月 31 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	累计已使用募集资金
1	昆山汉江精密连接器生产项目	23,687.01	23,687.01	12,536.24
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3	汽车高频信号线缆及连接器项目	15,765.83	15,067.67	684.13
4	半导体金属散热片材料项目	11,428.17	11,428.17	2,598.32
	合计	56,881.01	56,182.85	21,818.69

注 1：以上数据已经审计。

注 2：“汽车高频信号线缆及连接器项目”总投资共计为 15,765.83 万元，具体由募集资金 7,137.91 万元，超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万构成。

### 三、募投项目延期具体情况及主要原因

#### 1、募投项目延期具体情况

结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等都不发生变更的情况下，公司决定对募集资金投资项目中的“汽车高频信号线缆及连接器项目”、“半导体金属散热片材料项目”预计达到可使用状态的日期进行调整，具体

如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期 (调整前)	项目达到预定可使用状态日期 (调整后)
汽车高频信号线缆及连接器项目	2025年5月16日	2026年11月30日
半导体金属散热片材料项目	2025年5月16日	2026年11月30日

## 2、本次募投项目延期的原因

综合考虑未来市场环境、公司经营规划等因素后，为更好地满足下游市场的需求，进一步提升产品的综合竞争力，公司对“汽车高频信号线缆及连接器项目”、“半导体金属散热片材料项目”部分产品不断优化，同时不断调整、改进生产线配置，以提供更好的产品品质，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。结合募投项目当前的产线建设情况、设备调试进度等情况，经公司审慎研究决定，在该项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模等均不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 11 月 30 日。

## 四、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的建设内容、实施主体等，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

## 五、审议程序及相关意见

### (一) 董事会审议情况

公司 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均不发生变更的情况下，将募投项目中的“汽车高频信号线缆及连接器项目”、“半导体金属散热片材料项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 11 月 30 日。

### (二) 监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为公司本次部分募投项目延期，是根据项目实际实施进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模

等，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害投资者利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日